
南亞電路板股份有限公司 2021年上半年營運概況

2021年8月12日



免責聲明

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前南亞電路板股份有限公司之財務狀況或營運結果。

本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。

除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看法。



議程

- 公司概況
- 財務狀況
- 產品未來發展方向
- 未來營運目標



公司概況

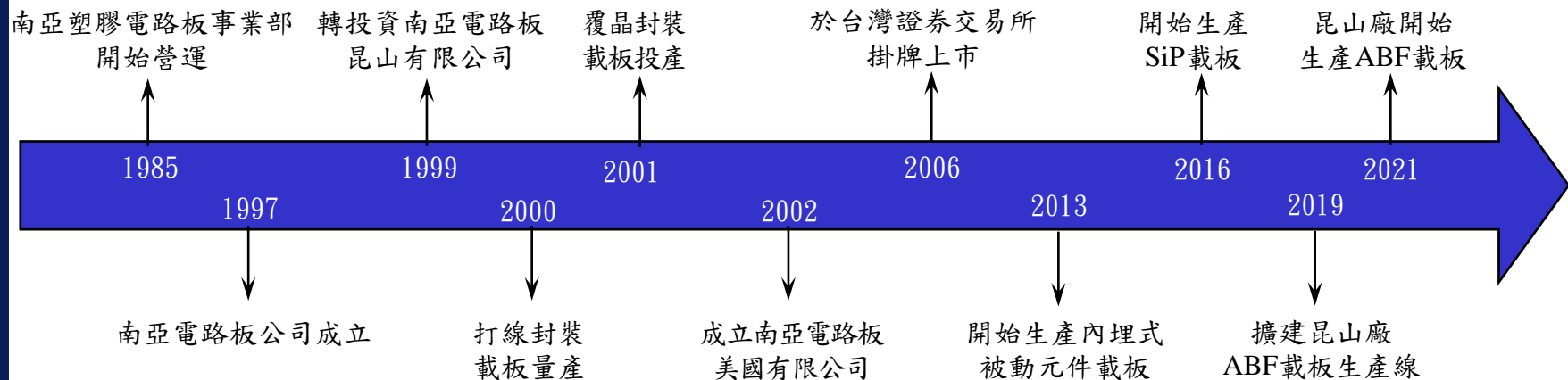
事業簡述

- 南亞塑膠工業股份有限公司之轉投資公司
- 生產與銷售一般電路板與IC載板
- 2021年上半年合併營業額為新台幣 233.4億元。
- 台股上市市值：新台幣2,516.8億元(2021年6月30日)
- 生產廠區：台灣、大陸



公司概況

歷史沿革



- 1985 : 南亞塑膠公司電路板事業部成立並開始生產一般電路板
- 1997 : 經南亞塑膠董事會通過，以轉投資方式成立南亞電路板公司
- 1999 : 轉投資南亞電路板(昆山)有限公司，註冊資本額2,980萬美元
- 2000 : 進入IC載板領域並量產打線封裝載板
- 2001 : 進行技術升級，開始投產覆晶封裝載板
- 2002 : 成立南亞電路板(美國)有限公司
- 2006 : 正式於台灣證券交易所掛牌上市，交易代號為8046
- 2013 : 產品技術升級，開始生產內埋式被動元件載板
- 2016 : 開始生產系統級封裝載板(System in Package, SiP)
- 2019 : 因應市場需求，開始於昆山廠擴建ABF載板生產線
- 2021 : 昆山廠開始生產ABF載板



財務狀況

近三年上半年合併營業收入(IFRS)

(新台幣百萬元)

營業額

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

2019年上半年

2020年上半年

2021年上半年

13,889.3

17,020.8

23,340.8

年成長率：+22.5%

年成長率：+37.1%

- 2020年上半年營收較2019年上半年增加22.5%：
本公司提早佈局高階網通與系統級封裝載板等 high value 產品市場，受益於客戶需求提升，2020年上半年營收比2019年同期顯著成長。
- 2021年上半年營收較2020年上半年增加37.1%：
本公司因遠距商務、居家娛樂等應用產品需求提升，營運績效淡季不淡，2021年上半年營收比2020年同期再成長。

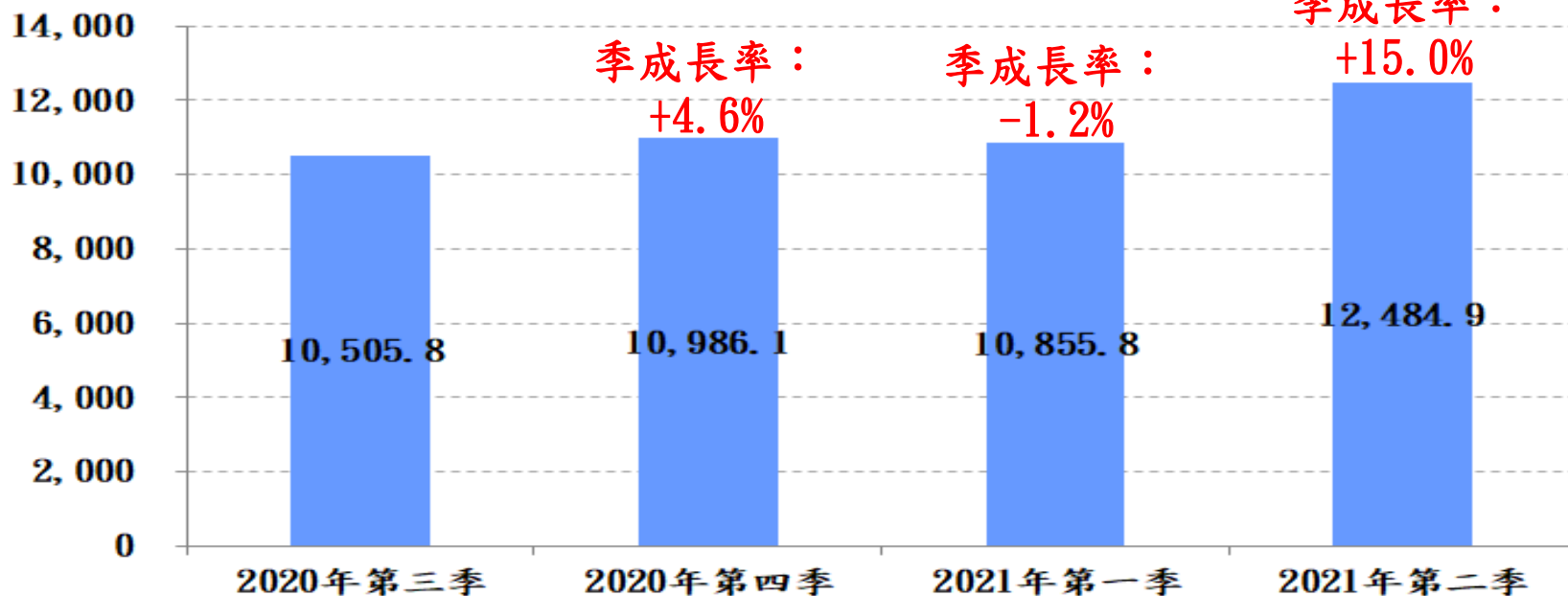


財務狀況

近一年每季合併營業收入(IFRS)

(新台幣百萬元)

營業額



■ 2020年第四季營收較第三季增加4.6%:

2020年第四季因電腦、網通及車用產品需求增加，營收進一步成長，達成營收季季增的目標。

■ 2021年第一季營收較2020年第四季減少1.2%:

2021年第一季因工作天數減少，營收比2020年第四季略為下滑。

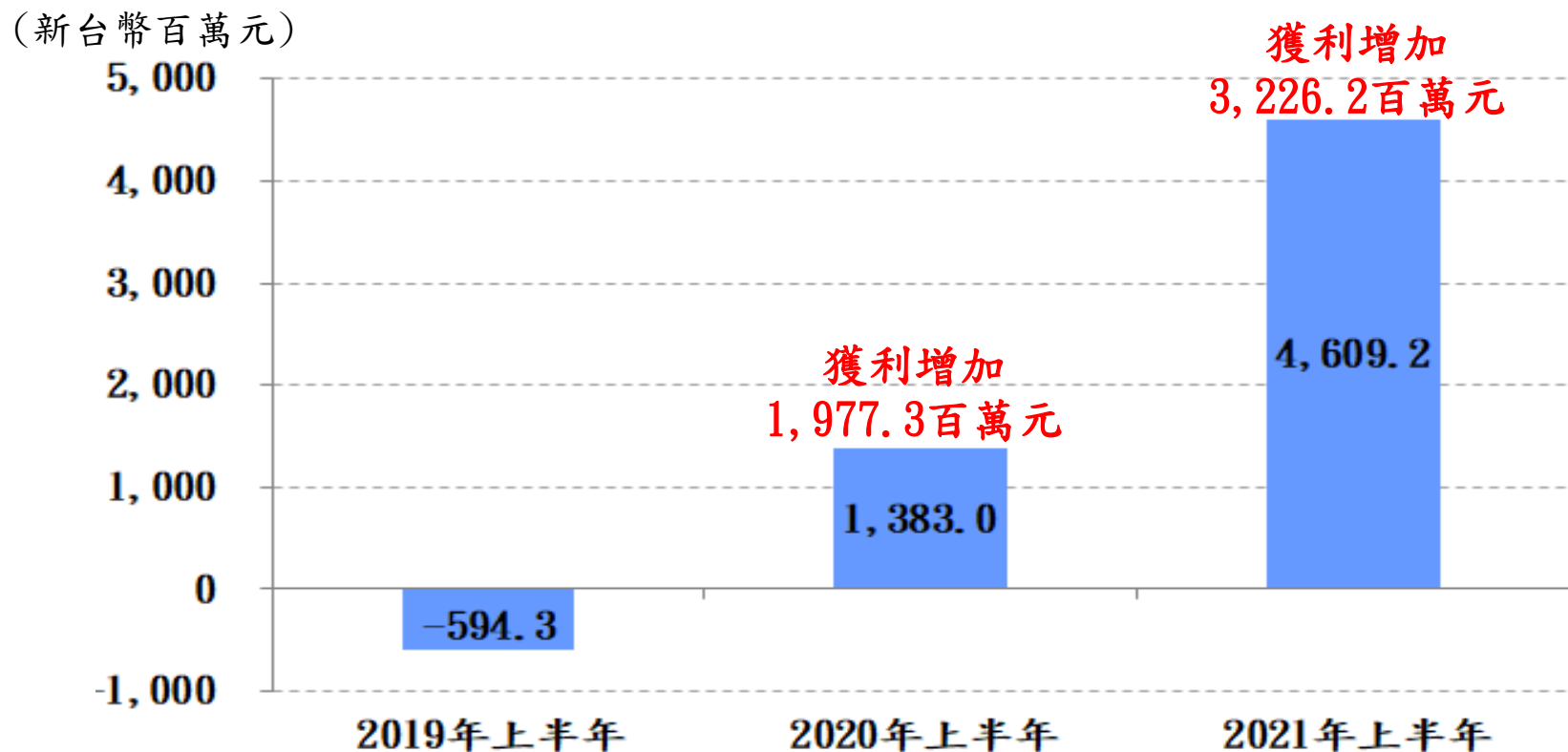
■ 2021年第二季營收較2021年第一季增加15.0%:

2021年第二季因高值化產品銷售增加與IC載板新產能挹注，營收比2021年第一季成長。



財務狀況

近三年上半年營業利益(虧損)



- 2020年上半年營業利益較2019年上半年增加1,977.3百萬元：
本公司2020年上半年持續優化製程，提升良率，且在高階網通產品銷售增加的情況下，2020年上半年營業利益轉虧為盈。
- 2021年上半年營業利益較2020年上半年增加3,226.2百萬元：
本公司除高值化產品銷售增加與IC載板新產能貢獻外，亦持續將人工智慧導入生產管理，優化製程，致2021年上半年營業利益持續提升。

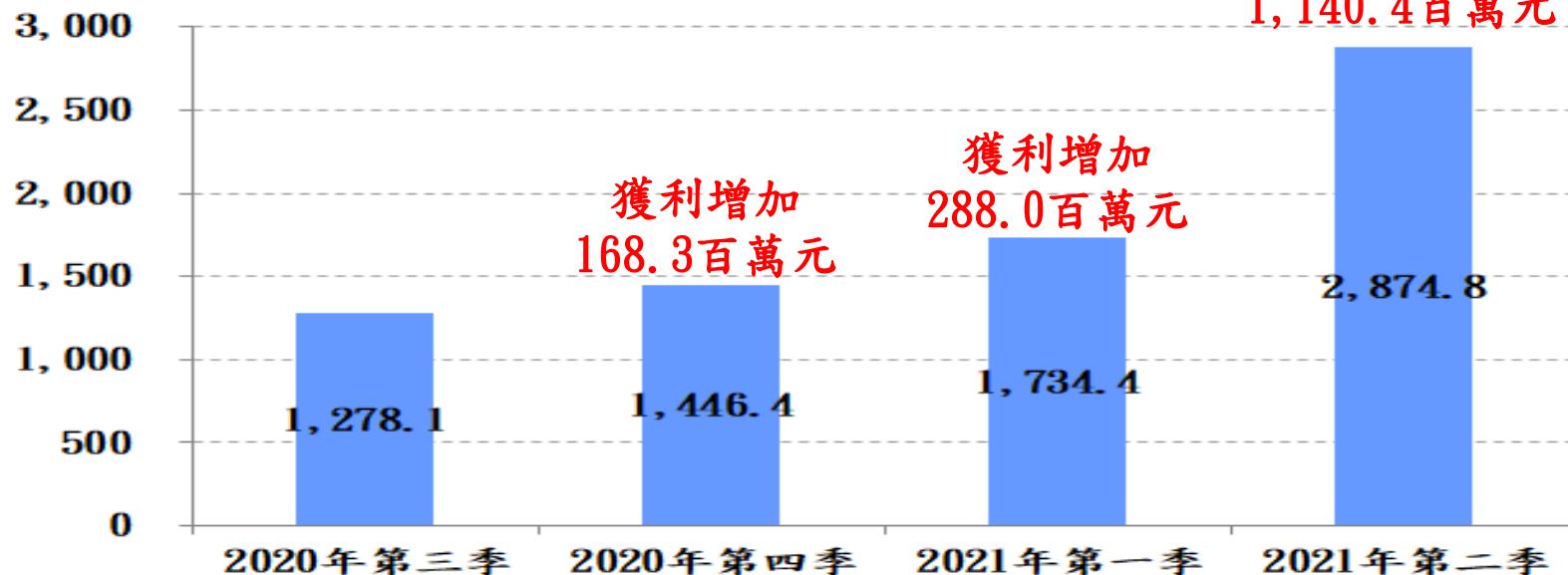


財務狀況

近一年每季營業利益

(新台幣百萬元)

營業利益



■ 2020年第四季營業利益較第三季增加168.3百萬元:

除高階網通需求持續增加外，筆記型電腦、遊戲機及車用電子等應用產品銷售暢旺，帶動第四季獲利成長，並達成營業利益季季增的目標。

■ 2021年第一季營業利益較2020年第四季增加288.0百萬元:

高階電腦處理器、繪圖晶片載板銷售成長，2021年第一季營業利益再提升。

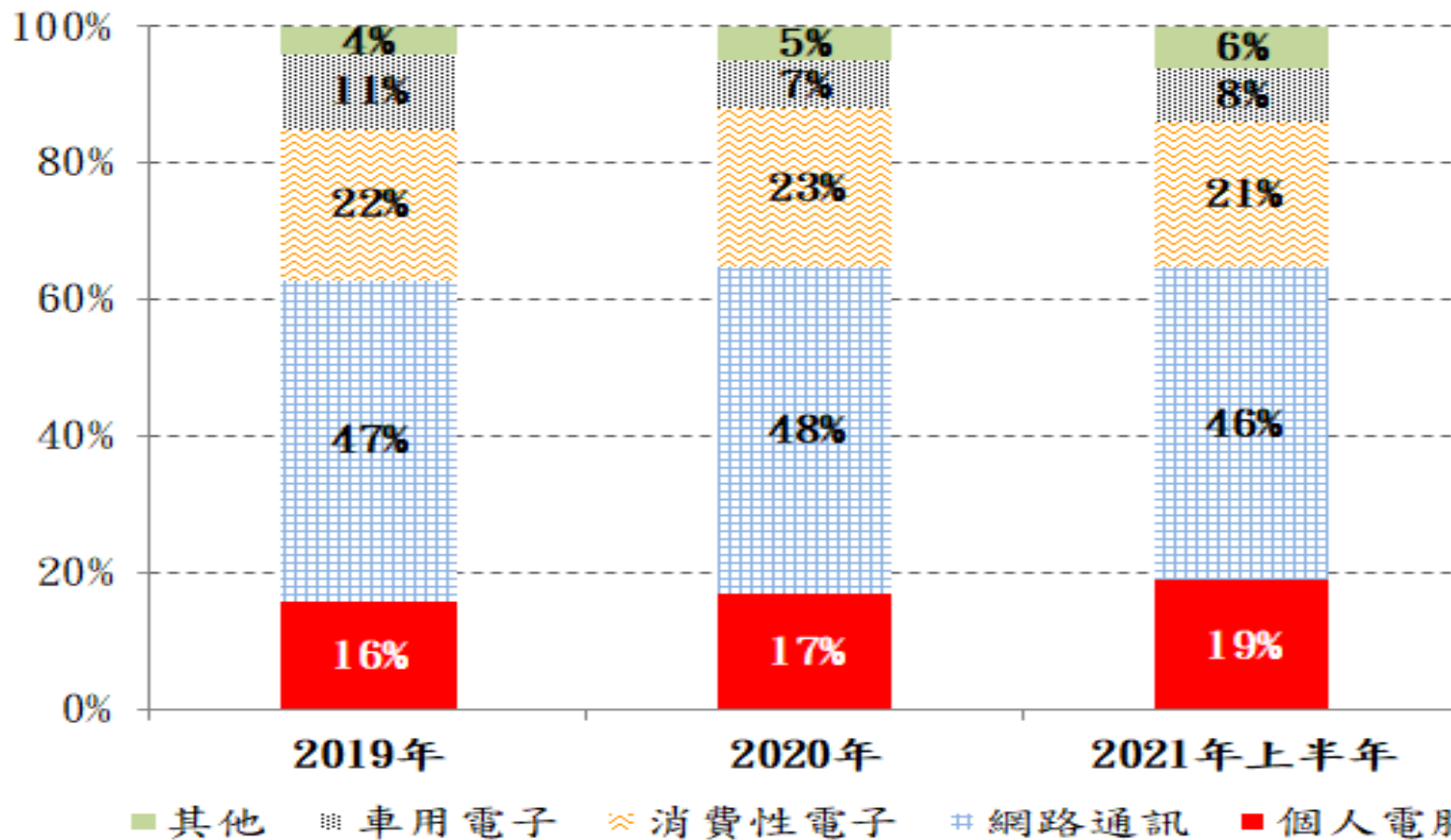
■ 2021年第二季營業利益較2021年第一季增加1,140.4百萬元:

因高值化產品銷售成長與IC載板新產能於2021年第二季全能生產，獲利持續提升。



財務狀況

營業收入結構(應用別)

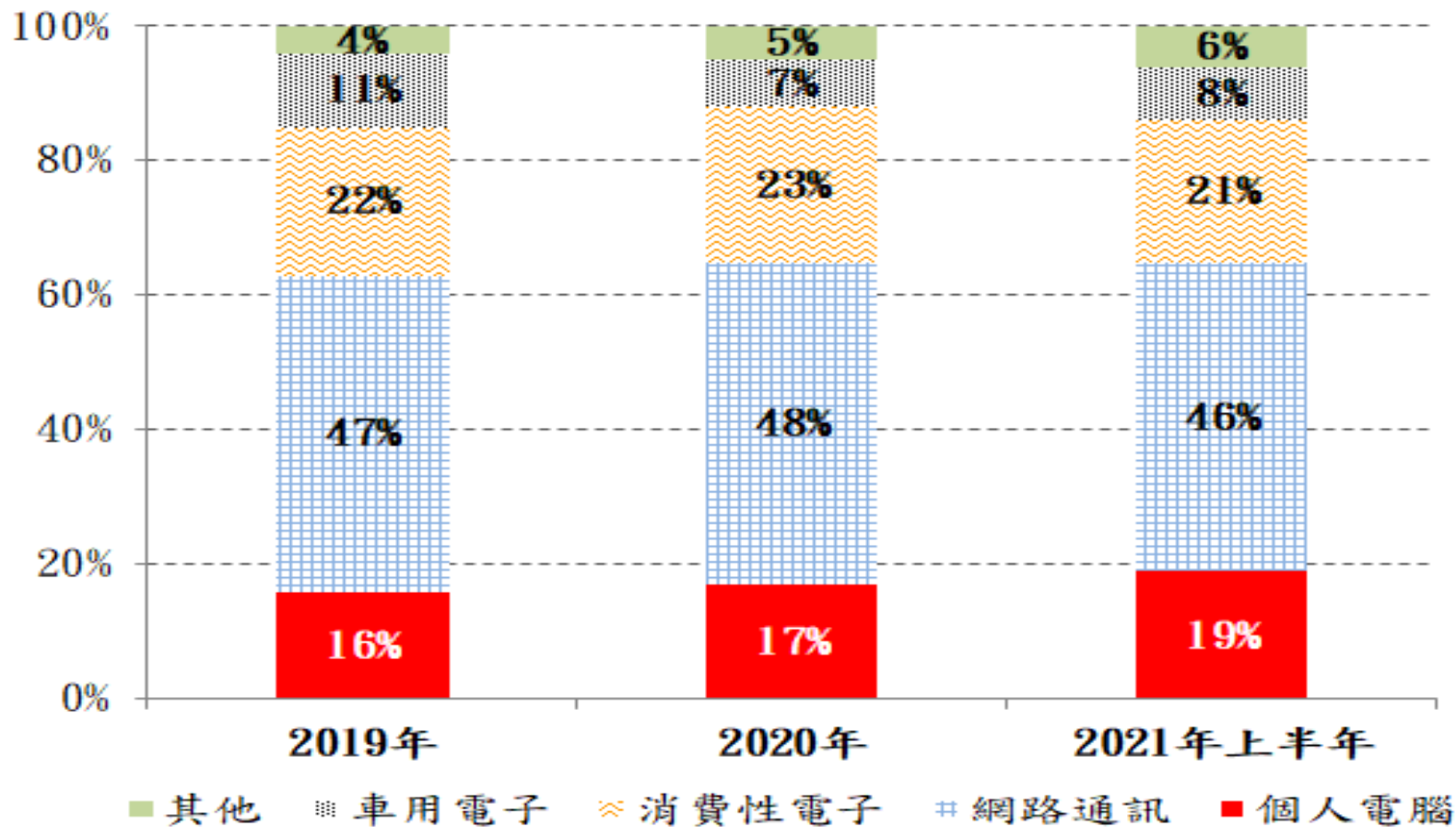


- 本公司個人電腦受益於遠距商務與居家娛樂需求增加，2021年上半年電腦營收比重持續提高。
- 因手機與真無線藍芽耳機等產品進入銷售淡季，2021年上半年網通與消費性電子營收比重下滑。



財務狀況

營業收入結構(應用別)



- 汽車市場受益於歐美地區新冠肺炎疫情減緩，銷售回升，致2021年上半年汽車應用產品營收比重提升。
- 本公司積極爭取人工智慧與高效運算等高值化產品訂單，故2021年上半年相關產品營收比重持續提升。



產品未來發展方向

持續拓展高值化產品

■ 高階ABF載板

2021年除持續布局中央處理器、繪圖晶片、高階網通載板市場外，人工智慧與高效運算應用產品銷售亦可望大幅增加；此外，車用運算晶片需求增加、小尺寸晶片封裝發展趨勢不變及全球5G基地台持續建置，均進一步推升ABF載板銷售。

■ SiP載板

因IC異質晶片封裝發展趨勢不變，系統級封裝(SiP)技術將大量應用在各項行動裝置，本公司將持續增加新世代穿戴裝置、高階5G手機相機、天線模組(AiP)及Type C控制器等SiP載板，未來SiP載板銷售量可望大幅增加。

■ 高密度連接板(HDI)

伴隨行動裝置、消費性及車用電子等產品設計愈趨精密，高值化之HDI使用量持續增加，今年將配合高階筆記型電腦需求成長與汽車市場回溫，量產新世代記憶體、固態硬碟及車用資訊娛樂系統等應用產品。另因5G網通基礎建設需求大幅增加，高階伺服器、微型基地台主板產品銷售量亦將逐年成長。



未來營運目標

營運管理方針

- 培養優秀的研發與製程技術人才。
- 持續深耕中央處理器、繪圖晶片、高階网通及高效運算等產品，提升高值化與尖端產品銷售比重。
- 持續將人工智慧導入生產管理，推動智能化生產，並優化製程條件與設備效能，以軟硬並進的策略，提升良率與效率。
- 錦興廠區將持續進行去化瓶頸製程，提高產能，目標於2021年底前完成，並於2022年第一季投產；加速進行樹林廠ABF載板產能擴建，目標於2022年底前完成，2023年第一季投產。
- 未來將再規劃新的IC載板產能擴建，持續擴大市場佔有率，並以本業獲利逐季成長為目標。



感謝您的聆聽

